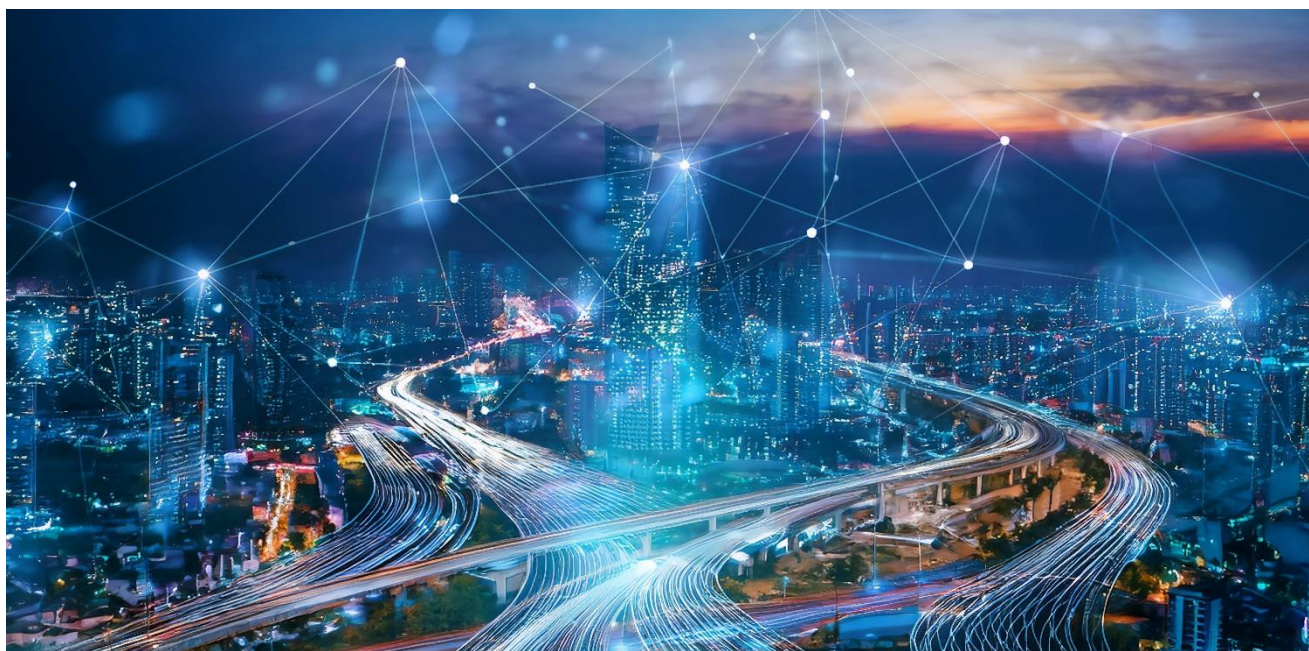


低誘電有機絶縁樹脂「スネクトン®」上市のお知らせ

デンカ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井 俊夫)は、次世代高速通信(Beyond5G、6G)において、電気信号の損失(伝送損失)を低減させるために素材に要求される電気特性(低誘電率、低誘電正接)を備えた低誘電有機絶縁樹脂(製品名：スネクトン®)を上市しました。

各種高速通信機器の銅張積層板(CCL)向けの販売を開始したほか、更に完全硬化後も軟質性を有するという特性により、フレキシブル銅張積層板(FCCL)や各種層間絶縁材用途での採用検討が進んでおり、PC、スマートフォン、データセンター、携帯電話基地局、ウェアラブル端末、自動車など幅広い分野への展開が期待されます。



SNECTON

デンカグループは2023年~2030年までの8か年を対象とした経営計画「Mission 2030」にて、「ICT & Energy」分野への注力を掲げており、「スネクトン®」は通信・エネルギー分野向けの中核素材として、社会やお客様のニーズに応じてまいります。

デンカはこれからも「化学の力で世界をよりよくするスペシャリストになる」というパーパスのもと、世界に誇れる化学で、人々の暮らしと社会に貢献します。

※スネクトン、SNECTON(文字 及び 図形)はデンカ株式会社の登録商標です。

以上

【報道関係者からのお問い合わせ先】

コーポレートコミュニケーション部 （電話：03-5290-5511）

【お客様からのお問い合わせ先】

電子・先端プロダクツ部門 先端機能材料部 （電話：03-5290-5539）